

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-33

投资者关系活动类别	√ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 现场参观 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	大和证券、野村资管、三菱 UFJ 资管、三井住友 DS 资管、东京海上资管、日本生命资管
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
时间	2025 年 10 月 15 日
地点	公司会议室
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍公司 2025 年半年度经营业绩情况。 公司把握 AI 算力升级、存储市场回暖和汽车电动智能化趋势深化的发展机遇。2025 年上半年，公司实现营业总收入 104.53 亿元，同比增长 25.63%，归母净利润 13.60 亿元，同比增长 37.75%。PCB 业务受益于 AI 加速卡、服务器等产品需求的释放，高速交换机、光模块需求的显著增加，以及汽车电子市场需求的增长。PCB 业务实现主营业务收入 62.74 亿元，同比增长 29.21%，业务毛利率 34.42%，同比增加 3.05 个百分点；封装基板业务主要受益于国内存储市场需求的回暖，公司在持续聚焦能力建设的同时，加速推进市场开发，推动订单收入增收。封装基板业务实现主营业务收入 17.40 亿元，同比增长 9.03%，业务毛利率 15.15%，同比减少 10.31 个百分点；电子装联业务把握数据中心及汽车电子领域的需求增长机会，推动营收增长。电子装联业务实现主营业务收入 14.78 亿元，同比增长 22.06%，毛利率 14.98%，同比增长 0.34 个百分点。

Q2、请介绍公司 2025 年上半年 PCB 业务产品下游应用经营情况。

公司在 PCB 业务方面从事中高端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。

2025 年上半年，通信、数据中心、汽车电子等领域对 PCB 业务营收增长均有贡献。在通信、数据中心领域，400G 及以上的高速交换机、光模块需求显著增长，AI 加速卡、服务器等及相关配套产品的需求提升，营收增长明显。在汽车领域，公司继续把握汽车电子需求增长的发展机遇，实现了订单收入的增加。PCB 业务毛利率的增长主要得益于营收规模增加，PCB 工厂产能利用率进一步提升，AI 相关领域订单需求增长助益 PCB 业务产品结构优化。

Q3、请介绍公司上半年工厂产能利用率情况。

公司 PCB 业务因算力及汽车电子市场需求持续提升，工厂综合产能利用率处于相对高位；封装基板业务受国内存储市场的需求明显提升，工厂综合产能利用率同比明显改善。

Q4、请介绍公司 FC-BGA 封装基板产品技术能力及广州封装基板项目爬坡进展。

公司已具备 20 层及以下 FC-BGA 封装基板产品批量生产能力，22~26 层产品的技术研发及打样工作按期推进中。公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单。2025 年上半年广州广芯亏损环比有所收窄。

Q5、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。

公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。公司电子装联业务 2024 年及 2025 年上半年分别实现主营业务收入 28.23 亿元、14.78 亿元，分别占公司营业总收入的 15.76%、14.14%。

	Q6、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。 公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2025 年上半年以来，受大宗商品价格变化影响，金盐等部分原材料价格仍呈上涨趋势。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无